

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2025年6月5日(05.06.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/115685 A1

(51) 国際特許分類:  
H05H 1/46 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/040864

(22) 国際出願日: 2024年11月18日(18.11.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

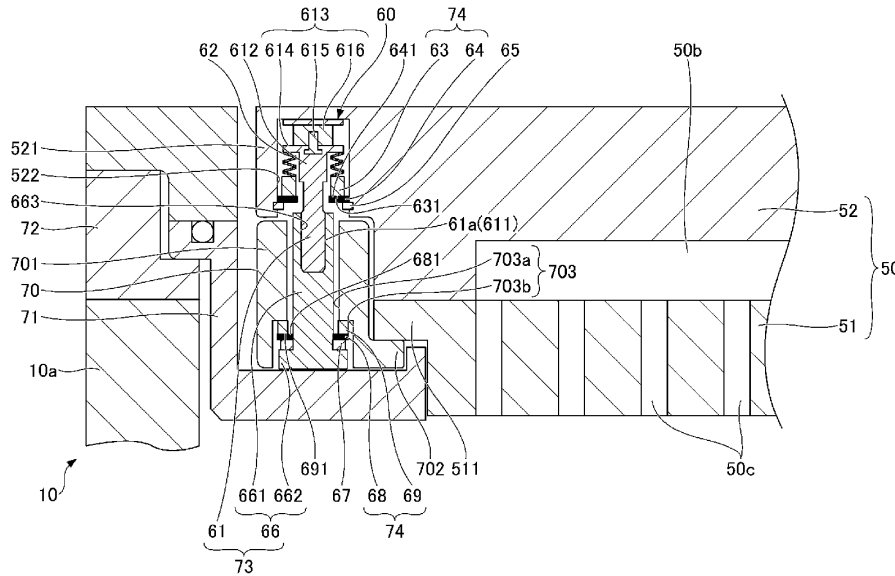
(30) 優先権データ:  
特願 2023-204089 2023年12月1日(01.12.2023) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 (JP).

(72) 発明者: 加藤 智也(KATO, Tomoya); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP). 加藤 健一(KATO, Kenichi); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP). 松本 和也(MATSUMOTO, Kazuya); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP). 太田 浩史(OHTA, Hirofumi); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP). ▲高 ▼▲瀬▼ 均(TAKASE, Taira); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP).

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING DEVICE AND CONNECTION ASSEMBLY

(54) 発明の名称: 基板処理装置、および連結アセンブリ



(57) Abstract: This substrate processing device processes a substrate. The substrate processing device comprises: a first member and a second member that are mutually laminated and that have mutually different thermal expansion coefficients; and a connection assembly that extends in parallel to the lamination direction of the first member and the second member and that connects the first member and the second member. The connection assembly has a sliding structure that can slide in a direction orthogonal to the lamination direction when the first member and/or the second member thermally expands.

[続葉有]

WO 2025/115685 A1

(74) 代理人: 弁理士法人 I T O H (ITOH PATENT ATTORNEY CORPORATION); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル 16階 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約: 基板処理装置は、基板を処理する。基板処理装置は、相互に積層され、かつ相互に異なる熱膨張係数を有する第1部材および第2部材と、前記第1部材および前記第2部材の積層方向に平行して延在し、前記第1部材と前記第2部材を連結する連結アセンブリと、を備える。前記連結アセンブリは、前記第1部材および/または前記第2部材の熱膨張時に、前記積層方向と直交する方向にスライド可能なすべり構造を有する。